

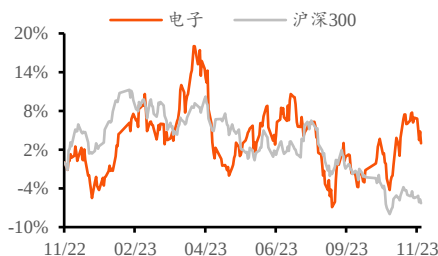
存储备货预期升温，HBM4 最早 2026 年量产 ——电子行业周报（2023.11.20-2023.11.24）



增持(维持)

行业： 电子
日期： 2023年11月28日
分析师： 陈宇哲
E-mail: chenyzhe@yongxingsc.com
SAC 编号: S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

相关报告：

《英伟达发布 H200，重点关注 HBM 相关产业链》

——2023 年 11 月 21 日

《AI 便携设备 Ai Pin 发布，台积电扩产 CoWoS 产能》

——2023 年 11 月 13 日

《长鑫新桥获大基金增资，华为先进封装专利公布》

——2023 年 11 月 07 日

■ 核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

HBM: SK 海力士计划将 HBM4 通过 3D 堆叠集成在芯片上，HBM 产业链有望持续受益。英伟达与 SK 海力士或将共同设计芯片，并委托台积电生产，HBM4 最早或将于 2026 年开始量产。从 2023 年到 2027 年，HBM 市场 CAGR 预计将升至 52%。HBM2023 年在 DRAM 市场收入中的份额预计将超过 10%，预计到 2027 年或将接近 20%。

AI 可穿戴: 首款可穿戴 AI 设备 AI Pin 发布，AI 可穿戴设备市场有望加速发展。首款可穿戴 AI 设备“AI Pin”于当地时间 11 月 9 日发布。漫步者 7 月表示与阿里集团下属人工智能公司签署合作开发智能耳机的协议书，相关产品已在研发中。

存储芯片: 存储现货市场行业备货热度升温，威刚预期 2024 年上半年 DDR5 将会超越 DDR4，存储芯片市场有望逐步向好。2023 年四季度国内行业市场需求有所回暖，终端回补库存以及提前锁货的需求，推动近期行业 SSD 和内存价格走高。威刚预期 2024 年上半年 DDR5 将会超越 DDR4。

先进封装: 美国公布《芯片法案》首项研发投资 30 亿美元资助先进封装行业，先进封装或将成为提升芯片性能的重要途径，国内先进封装产业链有望受益。我们认为，先进封装的市场比重或将逐渐超越传统封装，有望成为封测市场贡献主要增量，国内先进封装产业链或将深度受益。

市场行情回顾

本周（11.20-11.24），A 股申万电子指数下跌 3.72%，整体跑输沪深 300 指数 2.88pct，跑输创业板综指数 1.50pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：其他电子 II(-3.07%)、光学光电子(-3.12%)、消费电子(-3.45%)、元件(-3.89%)、半导体(-4.01%)、电子化学品 II(-4.22%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生科技(1.12%)、纳斯达克(0.89%)、道琼斯美国科技(0.67%)、台湾电子(0.26%)、费城半导体(-0.02%)、申万电子(-3.72%)。

■ 投资建议

本周我们继续看好受益英伟达 H200 发布的 HBM 产业链、受益 AI 赋能的智能可穿戴产业链、以存储、封装为代表的半导体周期复苏主线。

HBM: 受益于英伟达将 HBM3e 首次应用在新发布的 H200 算力芯片，HBM 产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等；

AI 可穿戴: 受益于 AI+ 可穿戴带来的创新体验和销量提升，相关产业链有望加速受益，建议关注漫步者、博硕科技、科大讯飞、国光电器、领益智造等；

存储芯片: 存储板块目前存在三因素共振：供应端推动 NAND 产品涨价；库存逐渐回到正常水位；AI 带动 HBM 与 DDR5 需求上升。建议关注东芯股份、江波龙、深科技、德明利、兆易创新等；

先进封装: 半导体大厂持续布局先进封装，产业链相关公司有望受益并迎来加速成长，建议关注甬矽电子、晶方科技、蓝箭电子、通富微电、长电科技等。

■ 风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

正文目录

1. 本周核心观点及投资建议	3
2. 市场回顾	5
2.1. 板块表现	5
2.1. 个股表现	7
3. 行业新闻	7
4. 公司动态	10
5. 公司公告	12
6. 风险提示	12

图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (11.20-11.24)	5
图 2: 申万电子二级行业一周涨跌幅情况 (11.20-11.24)	5
图 3: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (11.20-11.24)	6
图 4: 海内外指数涨跌幅情况 (11.20-11.24)	6

表目录

表 1: 电子板块 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (11.20-11.24)	7
表 2: 电子行业本周重点公告 (11.20-11.24)	12

1. 本周核心观点及投资建议

核心观点：

HBM：SK 海力士计划将 HBM4 通过 3D 堆叠集成在芯片上，HBM 产业链有望深度受益。根据韩国中央日报消息，SK 海力士计划将 HBM4 通过 3D 堆叠直接集成在芯片上，正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式，英伟达与 SK 海力士或将共同设计芯片，并委托台积电生产，HBM4 最早或将于 2026 年开始量产。根据市场研究公司 Omdia 报告，从 2023 年到 2027 年，HBM 市场 CAGR 预计将升至 52%。HBM2023 年在 DRAM 市场收入中的份额预计将超过 10%，预计到 2027 年或将接近 20%。

AI 可穿戴：首款可穿戴 AI 设备 AIPin 发布，AI 可穿戴设备市场有望加速发展。根据 IT 之家报道，由两位苹果公司的原设计和工程团队高管创立的 Humane 公司在当地时间 11 月 9 日发布首款可穿戴 AI 设备“Ai Pin”，这是一种安置在服装上的微型单色投影，可以投屏在手掌上进行交互。2023 年 7 月 19 日，漫步者在互动平台表示，公司近期确与阿里集团下属人工智能公司签署合作开发智能耳机的协议书，相关产品已在研发中。

存储芯片：存储现货市场行业备货热度升温，威刚预期 2024 年上半年 DDR5 将会超越 DDR4，存储芯片市场有望逐步向好。根据 CFM 闪存市场报道，由于原厂制程迭代产能调动，部分 Flash Wafer 资源持续紧俏，稀缺 NAND 资源涨价令供应端控货惜售。同时，前期持观望态度的部分终端，库存水位下降产生补货需求，在 2024 年涨价预期下，部分行业客户释放提前备货的需求。2023 年四季度国内行业市场需求有所回暖，终端回补库存以及提前锁货的需求，推动近期行业 SSD 和内存价格走高。根据中国台湾存储芯片厂商威刚表示，现阶段观察到需求复苏来临，主要来自于 PC，客户需求明显好转，且随着 PC 存储器内容提升，预期 2024 年上半年 DDR5 将会超越 DDR4。

先进封装：美国公布《芯片法案》首项研发投资 30 亿美元资助先进封装行业，先进封装或将成为提升芯片性能的重要途径，国内先进封装产业链有望受益。根据 NIST 美国国家标准与技术研究所公告，拜登政府美东时间 11 月 20 日宣布将投入大约 30 亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，这项投资计划的官方名称为“国家先进封装制造计划”。我们认为，先进封装的市场比重或将逐渐超越传统封装，有望成为封测市场贡献主要增量，国内先进封装产业链或将深度受益。

投资建议：

本周我们继续看好受益英伟达 H200 发布的 HBM 产业链、受益 AI 赋能的智能可穿戴产业链、以存储、封装为代表的半导体周期复苏主线。

HBM：受益于英伟达将 HBM3e 首次应用在新发布的 H200 算力芯片，HBM 产业链有望迎来加速成长，建议关注**赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科**等；

AI 可穿戴：受益于 AI+可穿戴带来的创新体验和销量提升，相关产业链有望加速受益，建议关注**漫步者、博硕科技、科大讯飞、国光电器、领益智造**等；

存储芯片：存储板块目前存在三因素共振：供应端推动 NAND 产品涨价；库存逐渐回到正常水位；AI 带动 HBM 与 DDR5 需求上升。建议关注**东芯股份、江波龙、深科技、德明利、兆易创新**等；

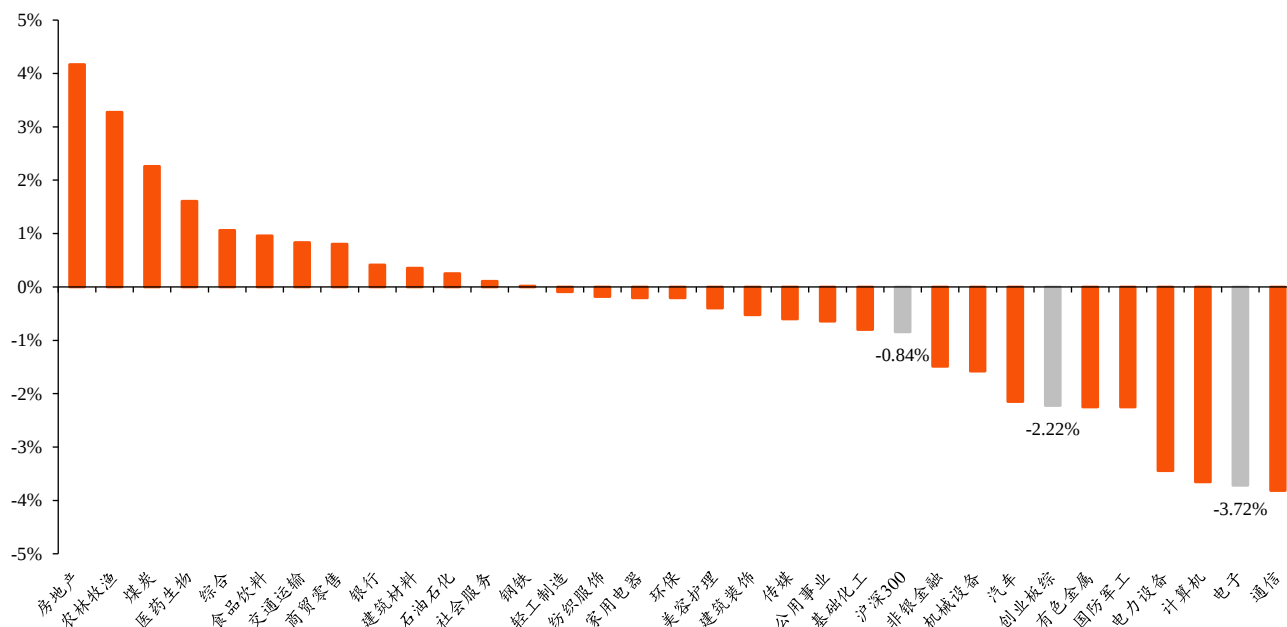
先进封装：半导体大厂持续布局先进封装，产业链相关公司有望受益并迎来加速成长，建议关注**甬矽电子、华海诚科、晶方科技、蓝箭电子、通富微电、长电科技**等。

2. 市场回顾

2.1. 板块表现

本周（11.20-11.24），A 股申万电子指数下跌 3.72%，板块整体跑输沪深 300 指数 2.88pct，跑输创业板综指数 1.50pct。在申万 31 个一级子行业中，电子板块周涨跌幅排名为第 30 位。

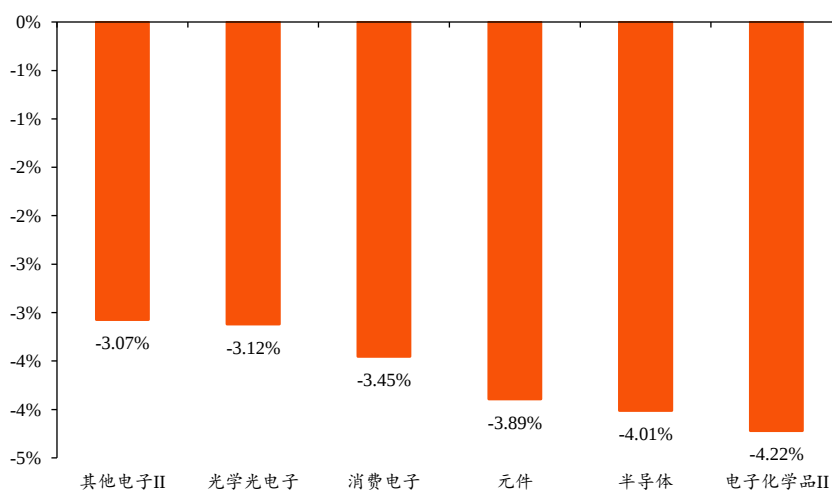
图1:A 股申万一级行业涨跌幅情况（11.20-11.24）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

本周（11.20-11.24）申万电子二级行业中，其他电子II板块下跌 3.07%，表现较差；电子化学品 II 板块下跌 4.22%，表现最差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为：其他电子 II(-3.07%)、光学光电子(-3.12%)、消费电子(-3.45%)、元件(-3.89%)、半导体(-4.01%)、电子化学品II(-4.22%)。

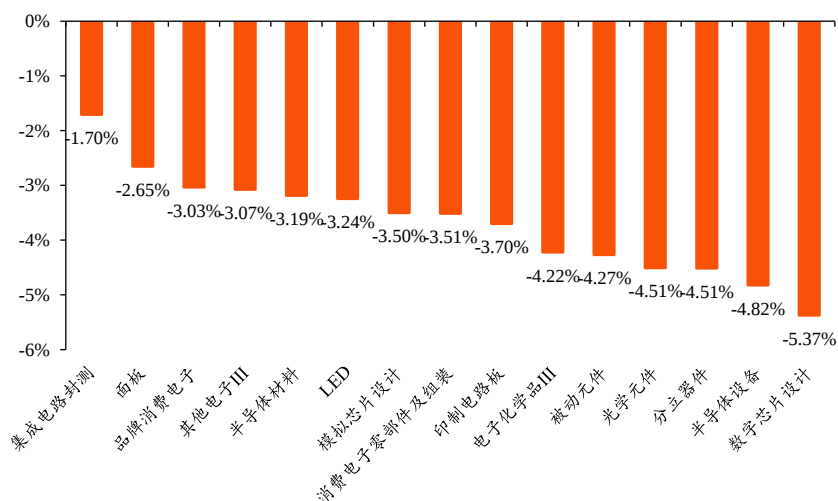
图2:申万电子二级行业一周涨跌幅情况（11.20-11.24）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

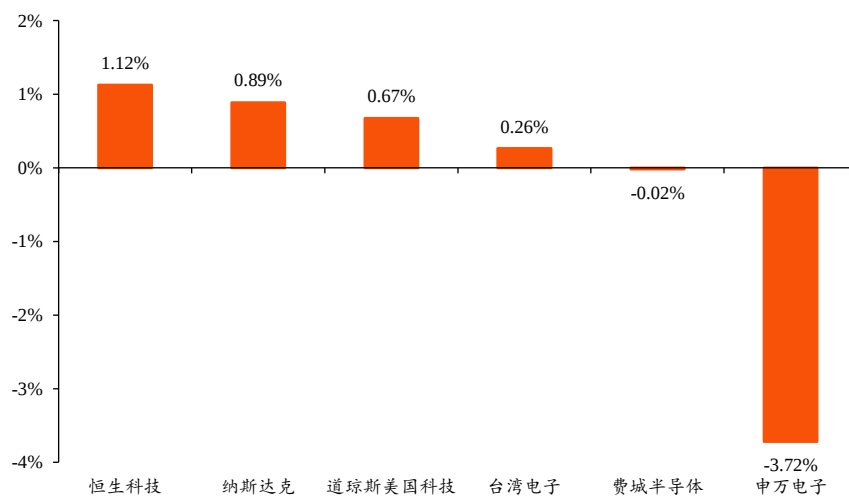
请务必阅读报告正文后各项声明

本周（11.20-11.24）申万电子三级行业中，集成电路封测板块下跌1.70%，表现较差；数字芯片设计板块下跌5.37%，表现最差。表现靠前的板块分别为：集成电路封测(-1.70%)、面板(-2.65%)、品牌消费电子(-3.03%)。表现靠后的板块分别为：数字芯片设计(-5.37%)、半导体设备(-4.82%)、分立器件(-4.51%)。

图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（11.20-11.24）


资料来源：Wind，甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势。本周（11.20-11.24），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生科技(1.12%)、纳斯达克(0.89%)、道琼斯美国科技(0.67%)、台湾电子(0.26%)、费城半导体(-0.02%)、申万电子(-3.72%)。

图4:海内外指数涨跌幅情况（11.20-11.24）


资料来源：Wind，甬兴证券研究所

2.1. 个股表现

本周（11.20-11.24）个股涨跌幅前十位分别为：凯华材料（+257.18%）、则成电子（+54.77%）、智新电子（+51.24%）、慧为智能（+43.55%）、泓禧科技（+40.33%）、伟时电子（+37.18%）、雅葆轩（+36.79%）、鑫汇科（+33.16%）、威贸电子（+31.83%）、惠威科技（+29.64%）。个股涨跌幅后十位分别为：香农芯创（-19.21%）、利通电子（-14.44%）、万润科技（-14.17%）、杰华特（-13.57%）、西陇科学（-13.25%）、创益通（-13.14%）、恒烁股份（-12.42%）、国芯科技（-12.28%）、中富电路（-11.94%）、冠石科技（-11.45%）。

表1:电子板块（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（11.20-11.24）

周涨跌幅前 10 名			周涨跌幅后 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
831526.BJ	凯华材料	257.18%	300475.SZ	香农芯创	-19.21%
837821.BJ	则成电子	54.77%	603629.SH	利通电子	-14.44%
837212.BJ	智新电子	51.24%	002654.SZ	万润科技	-14.17%
832876.BJ	慧为智能	43.55%	688141.SH	杰华特	-13.57%
871857.BJ	泓禧科技	40.33%	002584.SZ	西陇科学	-13.25%
605218.SH	伟时电子	37.18%	300991.SZ	创益通	-13.14%
870357.BJ	雅葆轩	36.79%	688416.SH	恒烁股份	-12.42%
831167.BJ	鑫汇科	33.16%	688262.SH	国芯科技	-12.28%
833346.BJ	威贸电子	31.83%	300814.SZ	中富电路	-11.94%
002888.SZ	惠威科技	29.64%	605588.SH	冠石科技	-11.45%

资料来源：Wind，甬兴证券研究所

3. 行业新闻

SK 海力士计划将 HBM4 通过 3D 堆叠直接集成在芯片上

11 月 20 日消息，根据韩国中央日报消息，SK 海力士聘请大量逻辑芯片设计人员，已有多名骨干人员组成团队，开始研究半导体设计。SK 海力士计划将 HBM4 通过 3D 堆叠直接集成在芯片上，发展方向已确定，具体商业模式正在推进。SK 海力士也正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式，英伟达与 SK 海力士或将共同设计芯片，并委托台积电生产。据悉，HBM4 最早将于 2026 年开始量产。

资料来源：(科创板日报)

美国公布《芯片法案》首项研发投资 30 亿美元资助先进封装行业

11 月 20 日消息，根据 NIST 美国国家标准与技术研究所公告，拜登政府美东时间 11 月 20 日宣布将投入大约 30 亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，这项投资计划的官方名称为“国家先进封装制造计划”。

资料来源：(NIST 美国国家标准与技术研究所)

上海：开展射频基带芯片、天线、专用算法、操作系统定制等关键技术研发

11月20日消息，上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知。开展射频基带芯片、天线、专用算法、操作系统定制等关键技术研发，形成高性价比终端制造能力。针对地面与卫星融合通信的新场景，开展场景智能识别、基于业务无感知的高可靠无缝切换等关键技术研究，研制满足6G空天地一体化系统性能需求、低成本、低功耗的终端芯片及模组。

资料来源：（上海市人民政府）

Canalys：2023年Q3苹果、三星TWS耳机出货量下滑，小米增长22%

11月21日消息，根据Canalys报告，2023年第三季度，全球真无线耳机（TWS）出货量增长3.9%。尽管TWS有所增长，但两大厂商苹果和三星的出货量均有下滑，苹果以27%的市场份额仍位列第一，但出货量下降8.3%。三星以8%市场份额排名第二，出货量下降9.5%。boAt和小米均有两位数的增长，并分别以7%和5%的市场份额位列第三和第四。尽管Skullcandy的出货量下降1%，但其成功取代OPPO成为前5大厂商。

资料来源：（Canalys）

TrendForce：镜头搭载趋势改变，预估影响2023年智能手机相机模组出货量年减8.9%

11月21日消息，根据TrendForce集邦咨询研究数据显示，受智能手机产量下滑，以及品牌厂搭载趋势改变的影响，预估2023年智能手机相机模组出货量年减幅度将再扩大至8.9%，约40.65亿颗。而经过一年的库存去化，在2024年智能手机生产量有望恢复的预期下，2024年智能手机相机模组市场有望恢复成长，出货量年增率预估3%，约41.71亿颗。

资料来源：（TrendForce）

CINNO：11月手机面板行情供需好转，价格有望上扬

11月21日消息，根据CINNO Research报告，进入第四季度，各技术别手机面板价格仍呈现“稳中有涨”态势，一方面因华为、苹果等主流品牌新机持续发布，智能手机终端市场逐步复苏带动上游面板市场持续向好，另一方面因产能结构的不断优化，供需关系好转，各模组厂产能均出现紧张情况。CINNO Research预测，11月和12月LTPS/柔性AMOLED整体价格将有机会小幅上涨，a-Si低价产品亦将小幅上涨。

资料来源：（CINNO）

存储现货市场行业备货热度升温，渠道承接力不足 SSD 行情倒挂

11月21日消息，根据 CFM 闪存市场报道，近期存储现货渠道和行业市场行情有所分化，渠道需求降温、SSD 出现倒挂行情，而行业市场近期客户备货意愿较强，加上部分稀缺资源持续走高，行业成品端行情继续上扬。渠道市场来看，随着国内电商促销结束，以及海外备货旺季过去，渠道市场备货需求明显降温，本周渠道 SSD 和内存价格环比持平。消费复苏力度不足而 Flash Wafer 仍有上涨空间，渠道 SSD 行情开始出现倒挂，这种市况下或将加速推动 QLC NAND 的应用，以缓解渠道 SSD 倒挂并满足部分市场需求。整体来看，近期渠道行情呈现上热下冷的市况，渠道备货需求的季节性降温，令现阶段渠道市场对 NAND 涨价的承接力有限，市场再度出现供需博弈。而行业市场近期热度有所升温，行业客户表现出较强的备货意愿，供需状况也更为明朗。由于原厂制程迭代产能调动，部分 Flash Wafer 资源持续紧俏，稀缺 NAND 资源涨价令供应端控货惜售。同时，前期持观望态度的部分终端，库存水位下降产生补货需求，2024 年涨价预期下，部分行业客户释放提前备货的需求。2023 年四季度国内行业市场需求有所回暖，终端回补库存以及提前锁货的需求，推动本周行业 SSD 和内存价格走高。

资料来源：(CFM 闪存市场)

Canalys：预计 2024 年全球智能手机出货量预计为 11.7 亿，同比上涨 4%

11月22日消息，根据 Canalys 报告，全球智能手机市场在 2022 年下降 12% 后暗示了复苏的早期迹象。虽然预计 2023 年出货量仍将下降 5%，但随着中东、非洲和拉丁美洲等地区 2023 年分别以 9%、3% 和 2% 的速度恢复增长，下降幅度趋于稳定。2023 年全年智能手机出货量将达到 11.3 亿部，预计增长 4%，到 2024 年将达到 11.7 亿部。预计 2027 年智能手机市场出货量将达到 12.5 亿台，2023 年至 2027 年复合年增长率为 2.6%。

资料来源：(Canalys)

Omdia：2023 年到 2027 年 HBM 市场年复合增长率或将升至 52%

11月24日消息，根据市场研究公司 Omdia 分析显示，SK 海力士第三季度在 DRAM 领域的市场份额已达到 35%。随着高带宽内存（HBM）在人工智能时代（AI）的重要性日益增加，预计 DRAM 行业将转向以质量为中心的“赢者通吃”。Omdia 研究显示，从 2023 年到 2027 年，DRAM 市场收入的年复合增长率预计为 21%，而 HBM 市场预计将升至 52%。HBM2023 年在 DRAM 市场收入中的份额预计将超过 10%，到 2027 年将接近 20%。

资料来源：(科创板日报)

威刚：预期 2024 年上半年 DDR5 将会超越 DDR4

11 月 24 日消息，根据中国台湾存储芯片厂商威刚表示，现阶段观察到需求复苏来临，主要来自于 PC，客户需求明显好转，且随着 PC 存储器内容提升，预期 2024 年上半年 DDR5 将会超越 DDR4，形成黄金交叉。以目前现货市场来看，DDR5 单价较 DDR4 高四至五成。

资料来源：(科创板日报)

4. 公司动态

【光峰科技】车载业务 2023 年新增定点客户包括比亚迪、赛力斯等

11 月 20 日消息，光峰科技在接受机构调研时表示，公司重视车载光学核心器件业务的发展，围绕车载显示、AR-HUD、激光大灯三大业务线，积极拓展定点合作落地。2023 年新增的定点客户包括比亚迪汽车工业有限公司、赛力斯集团股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司等。

资料来源：(公司公告)

【晶合集成】40nm OLED 驱动芯片已正式流片

11 月 20 日消息，晶合集成在接受调研时表示，在新产品方面，公司 40nm 的 OLED 驱动芯片已经开发成功并正式流片。OLED 目前在手机端的渗透率比较高，预计后续会进一步提升，但 OLED 目前在使用 LCD 的中大尺寸面板终端产品上的渗透率较低。

资料来源：(公司公告)

【壹石通】公司 Low- α 球形氧化铝产品已做好产能准备

11 月 20 日消息，壹石通在接受机构调研时表示，HBM 封装所需的环氧塑封料，其中最主要的功能填充材料就是 Low- α 球形二氧化硅或 Low- α 球形氧化铝，两者的使用场景取决于散热要求，散热要求越高，Low- α 球铝的使用占比会越高，甚至全部使用。公司 Low- α 球形氧化铝产品的直接用户主要是 EMC（环氧塑封料）、GMC（颗粒状环氧塑封料）厂家，在客户端测试验证进展顺利，但尚未收到批量订单。已经做好了产能准备，希望定增募投项目 200 吨的产能用两年左右的时间去消化。

资料来源：(公司公告)

【欧菲光】长焦镜头、微距镜头等产品均已进入国内主流手机厂商镜头供应链

11 月 21 日消息，欧菲光在互动平台表示，公司凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势，以及自主开发的 AA 对焦工艺、高

自动化水平的产线和大规模量产能力，已成为行业内的高像素摄像头模组的主流供应商。公司光学镜头业务进展顺利，高端镜头加速渗透，产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀，突破高端镜头技术壁垒；一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头、内对焦镜头已批量生产；长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。

资料来源：（投资者互动平台）

【通富微电】公司有涉及 AMD Rx 7900 m GPU 的封测项目

11月23日消息，通富微电在互动平台表示，公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司持续推进5nm、4nm、3nm新品研发，凭借FCBGA、Chiplet等先进封装技术优势，不断强化与客户的深度合作，满足客户AI算力等方面的需求。公司有涉及AMD Rx 7900 m GPU的封测项目。

资料来源：（投资者互动平台）

【澜起科技】公司的CKD芯片有望2024年下半年开始上量

11月23日消息，澜起科技接受机构调研时称，由于AIPC需要更高带宽的内存提升整体运算性能，AIPC渗透率的提升或将加速DDR5子代迭代以及增加更高速率DDR5内存的需求，从而加快CKD的芯片的上量节奏及提升未来CKD芯片的整体需求量。公司已于2022年9月发布业界首款DDR5第一子代CKD芯片工程样片。根据某主流CPU厂家最新产品路线图，其支持DDR5 6400MT/s的客户端CPU平台预计2024年上市，因此，公司的CKD芯片有望2024年下半年开始上量。

资料来源：（公司公告）

【沃格光电】公司玻璃基线路板目前主要应用领域包括Mini背光、Micro直显和IC先进封装载板

11月24日消息，沃格光电在互动平台表示，公司玻璃基线路板（含TGV玻璃通孔产品）目前主要应用领域包括Mini背光、Micro直显和IC先进封装载板，玻璃作为上述领域新材料的技术迭代应用受到行业广泛关注。

资料来源：（投资者互动平台）

5. 公司公告

表2:电子行业本周重点公告（11.20-11.24）

日期	公司	公告类型	要闻
2023/11/20	芯瑞达	资金投向	芯瑞达：安徽芯瑞达科技股份有限公司拟借助产业链资源整合，通过提高厂商供应链级次，推动公司车载显示业务快速起量、成长，提升整体竞争实力与盈利能力，实现可持续发展。公司拟与芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业、合肥耀慧企业管理有限公司、盈泰信息咨询（深圳）合伙企业、安徽瑞龙产业投资合伙企业签署《投资协议书》，共同出资 10,000 万元人民币设立安徽瑞龙汽车电子有限公司。公司拟以自有资金出资 3,000 万元人民币占股 30%。
2023/11/20	至纯科技	权益变动	至纯科技：上海至纯洁净系统科技股份有限公司持有贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 26.91% 的股份，共计 1785 万股。本次公司转让股份数量为 669.03 万股，占公司持股份额的 37.48%，占威顿晶磷股份总额的 10.09%，股权转让金额合计 17,500 万元。
2023/11/22	联创电子	股本变动	联创电子：关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份流通的提示性公告，本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 11 月 28 日。本次解除限售的限制性股票数量为 318.78 万股，占截至 2023 年 11 月 21 日公司总股本的 0.30%。
2023/11/23	气派科技	股权激励	气派科技：确定公司 2023 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 11 月 23 日，以 13.73 元/股的授予价格向符合授予条件的 125 名激励对象授予限制性股票 90.35 万股。
2023/11/23	新相微	股本变动	新相微：本次上市流通的网下配售限售股份数量总数为 5,150,486 股。本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 1 日。
2023/11/24	晶晨股份	股权激励	晶晨股份：公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划拟向激励对象授予不超过 140.76 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.338%。

资料来源：Wind，甬兴证券研究所

6. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权归属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。